

株式会社テラプローブ 決算説明資料

2013年3月期 第1四半期

2013年3月期第1四半期
業績説明

今回の発表の概要

メモリ事業

- QoQではテスト時間の長いDRAMの受託量は増加、YoYでは減少
- 主に台湾においてその他メモリ製品の受託量はQoQでは増加だがYoYでは減少
- 中長期的な取引関係を考慮し、一定の条件を前提に価格見直し

システムLSI事業

- テスト受託はQoQでは横ばいだが、YoYでは減少
- ウエハレベルパッケージ(WLP)受託はQoQでは増加
(YoYでは純増)

2012年度第1四半期 実績

(億円)

		四半期実績前年同期比較			四半期実績前四半期比較		
		1Q/FY2011	1Q/FY2012	YoY増減	4Q/FY2011	1Q/FY2012	QoQ増減
売上高	メモリ	54.1	41.1	-24%	46.1	41.1	-11%
	システムLSI	5.4	20.1	272%	16.3	20.1	23%
	その他	0.1	0.0	—	-0.1	0.0	—
売上高		59.7	61.2	3%	62.2	61.2	-2%
営業利益	メモリ	17.2	6.2	-64%	9.8	6.2	-37%
	システムLSI	-1.4	1.4	—	-3.6	1.4	—
	その他	-2.8	-3.8	—	-3.4	-3.8	—
営業利益		13.0	3.8	-71%	2.8	3.8	37%
営業利益率		22%	6%	—	4%	6%	—
当期純利益		7.1	2.5	-64%	-68.6	2.5	—
当期純利益率		12%	4%	—	—	4%	—

※3Q/FY2011よりシステムLSI事業にWLPが含まれております

第1四半期実績増減分析(売上高)

1Q実績(YoY)

<メモリ事業>

・前年度1Qは好調だったが、当1Qは微細化進行するも受託量減少により約13億円減

<システムLSI事業>

・テラミクロスの連結子会社化によりWLPの売上約15億円増

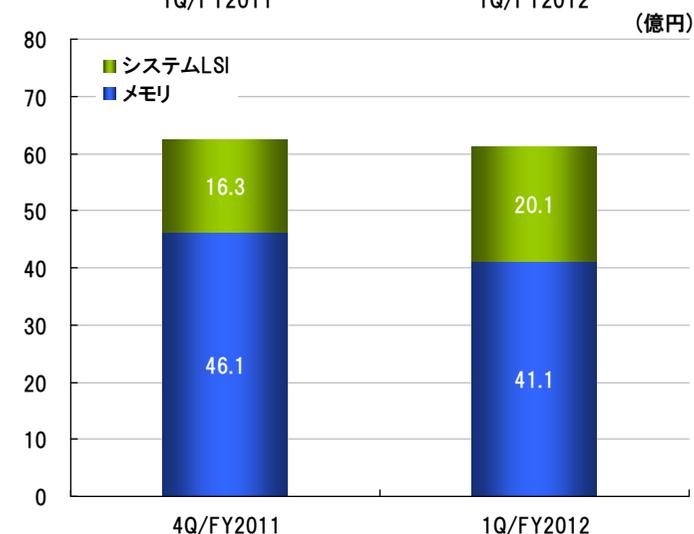
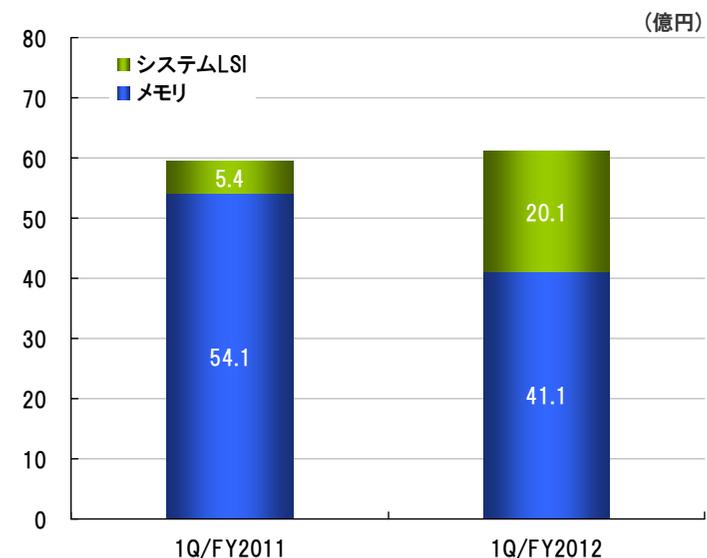
1Q実績(QoQ)

<メモリ事業>

・テスト時間の短縮と価格見直し等により約5億円減

<システムLSI事業>

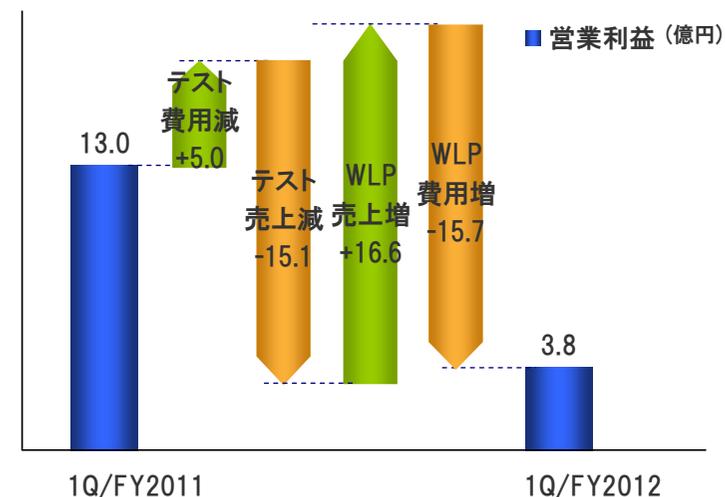
・WLPの受託回復等により約3億円増



第1四半期実績増減分析(営業利益)

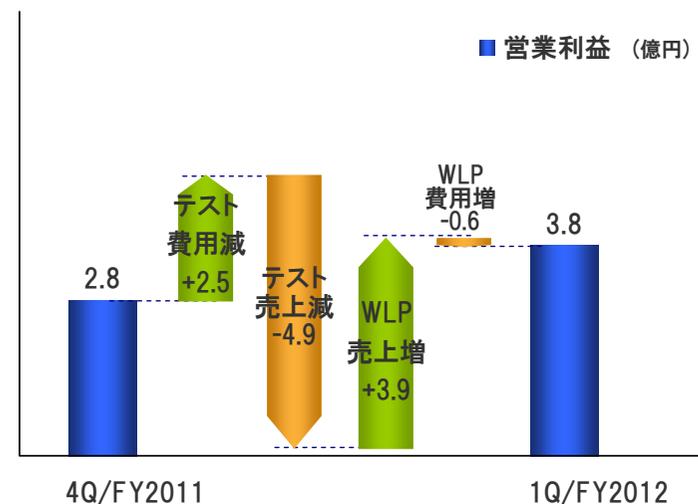
1Q実績(YoY)

- ・WLP受託により売上高増加するものの、テスト受託の減少により差し引き1.5億円の増加にとどまる
- ・テスト受託で経費削減するも、WLP受託により費用約11億円の増加



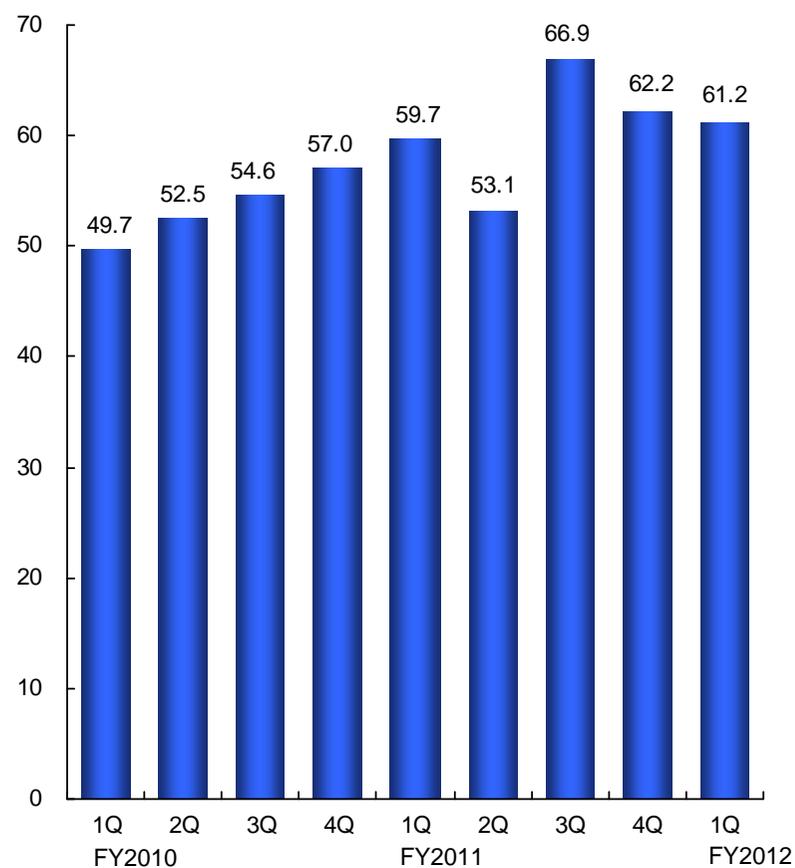
1Q実績(QoQ)

- ・受託量の減少等により売上高約1億円減少
- ・償却費等削減により費用約2億円減少

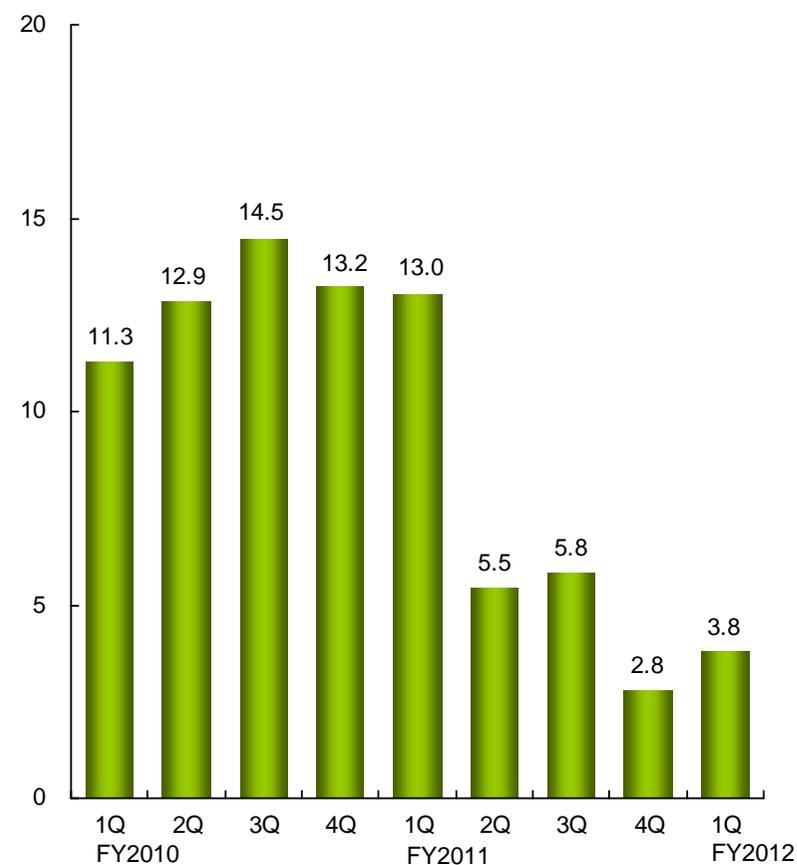


売上高及び営業利益推移

売上高推移



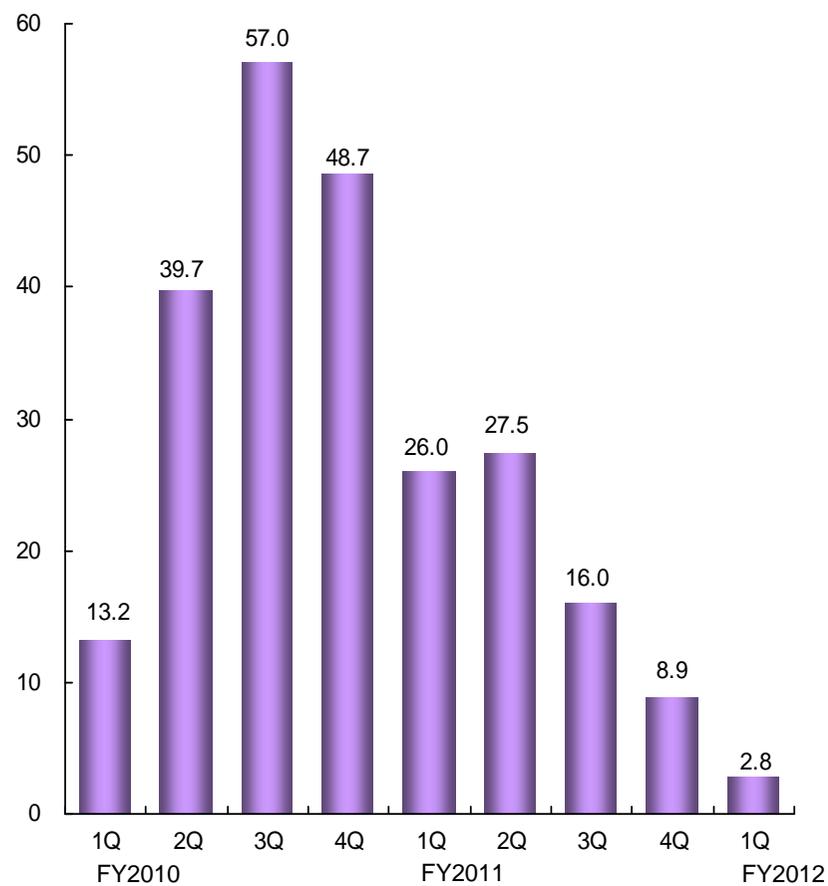
営業利益推移



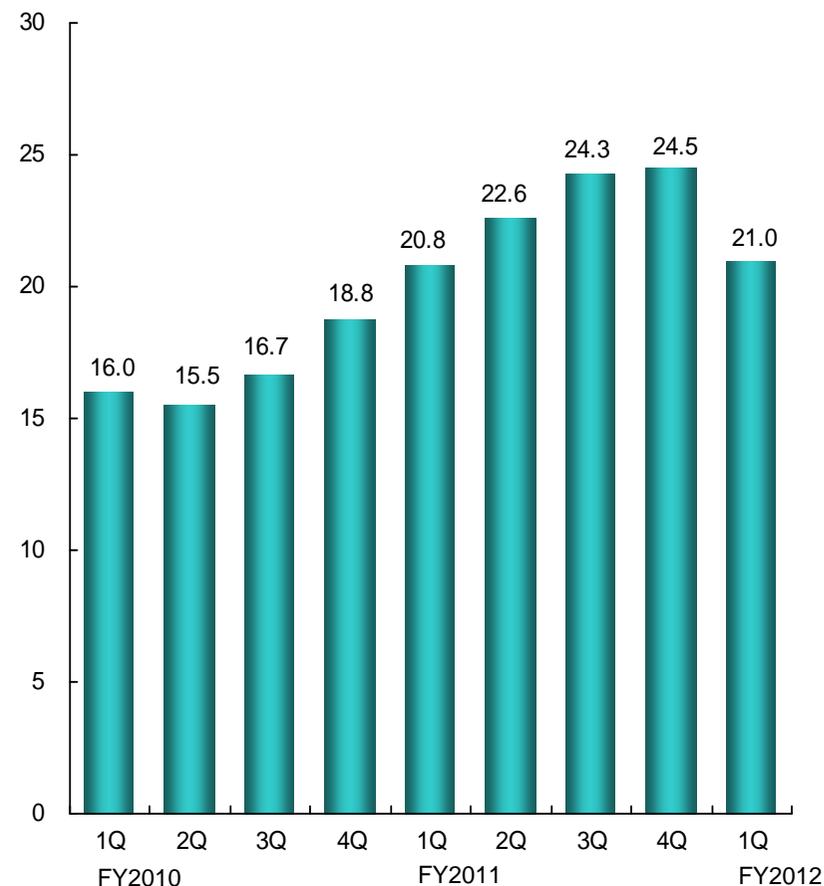
単位: 億円

設備投資及び減価償却

設備投資額推移



減価償却費推移

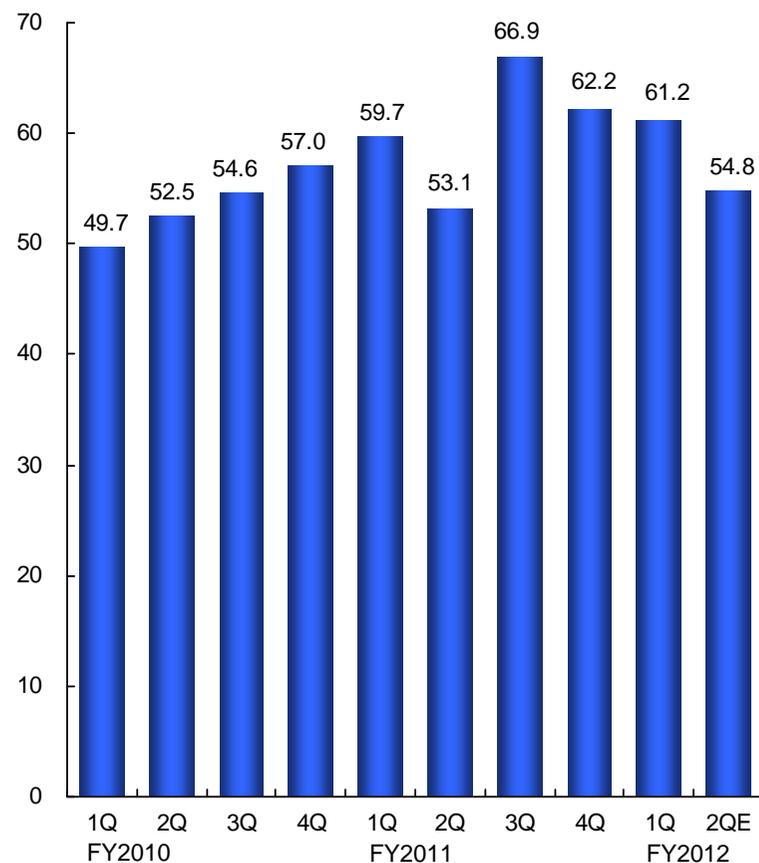


単位: 億円

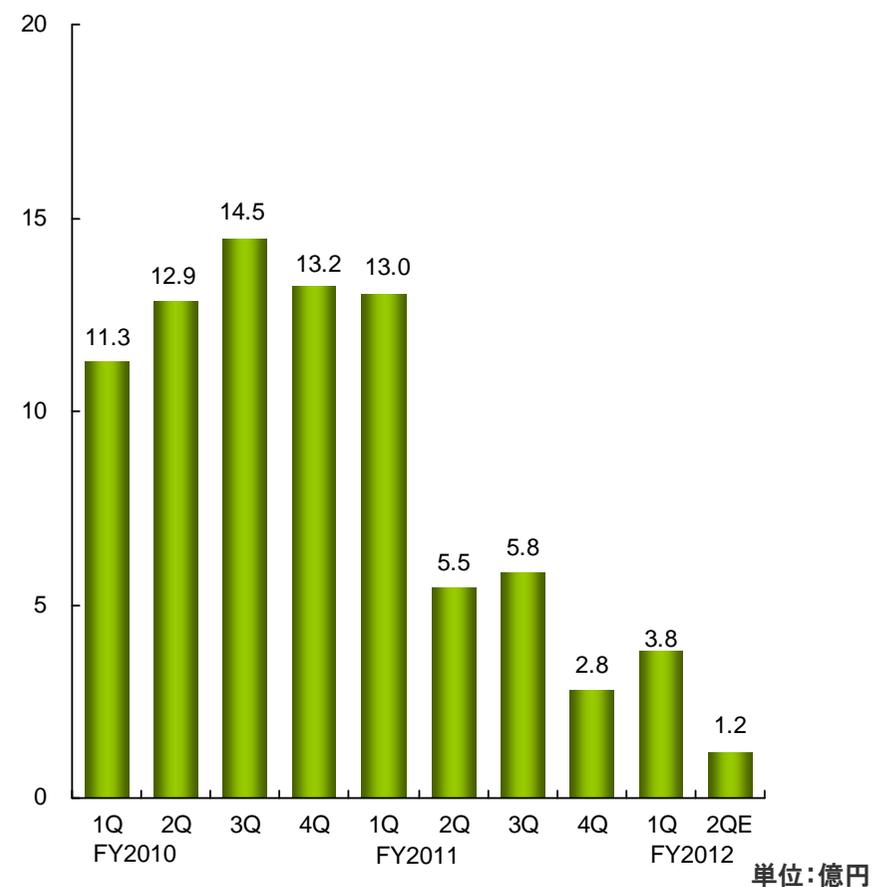
2013年3月期第2四半期業績予想

売上高及び営業利益推移

売上高推移



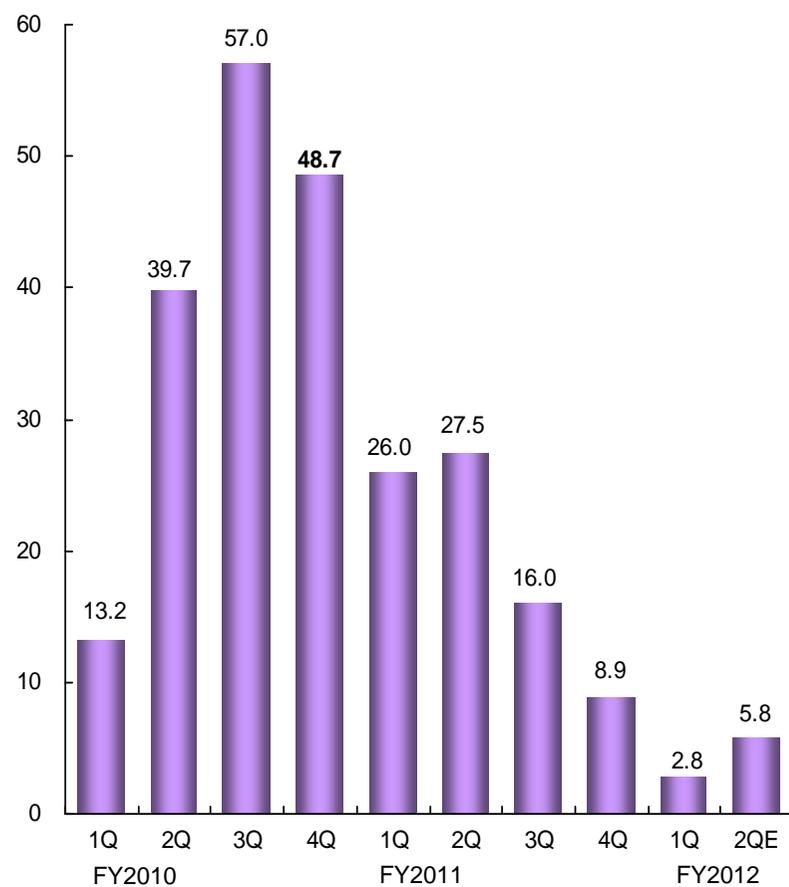
営業利益推移



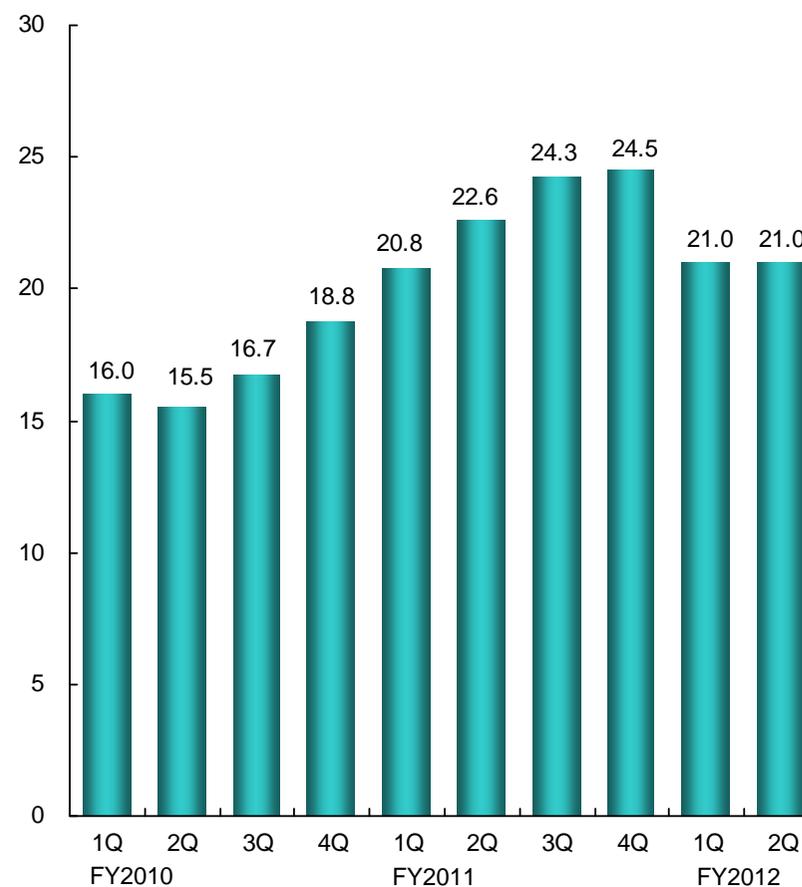
当社グループが属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、1年間の業績予想を作成することが困難であることから、連結業績予想は翌四半期のみを開示することといたします。

設備投資及び減価償却

設備投資額推移



減価償却費推移



単位: 億円

第2四半期業績予想の概要

メモリ事業

- テスト時間の長い製品は堅調に推移
- テスト時間の短い製品は低調

システムLSI事業

- テスト受託は新規受託もあり堅調に推移
- WLP受託は受託量が減少



**新規受託の推進、費用削減を進めるが
減収減益を予想**

会社説明資料

会社概要

社 名	株式会社 テラプローブ（英文名称:Tera Probe, Inc.）
本 社 所 在 地	神奈川県 横浜市 港北区 新横浜二丁目7番17号
代 表 者	代表取締役社長 渡辺 雄一郎 代表取締役副社長 小平 広人
設 立	2005年8月
事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ メモリ事業 (DRAM等のメモリ製品のウエハテスト、ファイナルテスト、 開発受託及びWLP受託) ・ システムLSI事業 (SoC、イメージセンサ、アナログ等の各種半導体製品 のウエハテスト、ファイナルテスト、開発受託及びWLP受託)
資 本 金	11,823百万円
連 結 子 会 社	TeraPower Technology Inc.（半導体ウエハテスト受託） 株式会社テラミクロス（ウエハレベルパッケージ受託）
従 業 員 数	294名(単体)、660名(連結)

2012/3末現在

事業拠点

The map shows the locations of Tera Probe's business bases. Red dots indicate the locations: Taiwan (New Taipei City), Kyushu (Nobeoka), Hiroshima (Hiroshima), and Japan (Yokohama, Aoyama, Nobeoka, Hiroshima). Blue lines connect these dots to their respective detail boxes.

海外拠点 (台湾)

TeraPower Technology Inc. (台湾新竹縣)

●台湾のテスト拠点

国内拠点

本社・開発センター (神奈川県横浜市)

Teramikros (東京都青梅市)

●WLPの生産拠点

九州事業所 (熊本県葦北郡)

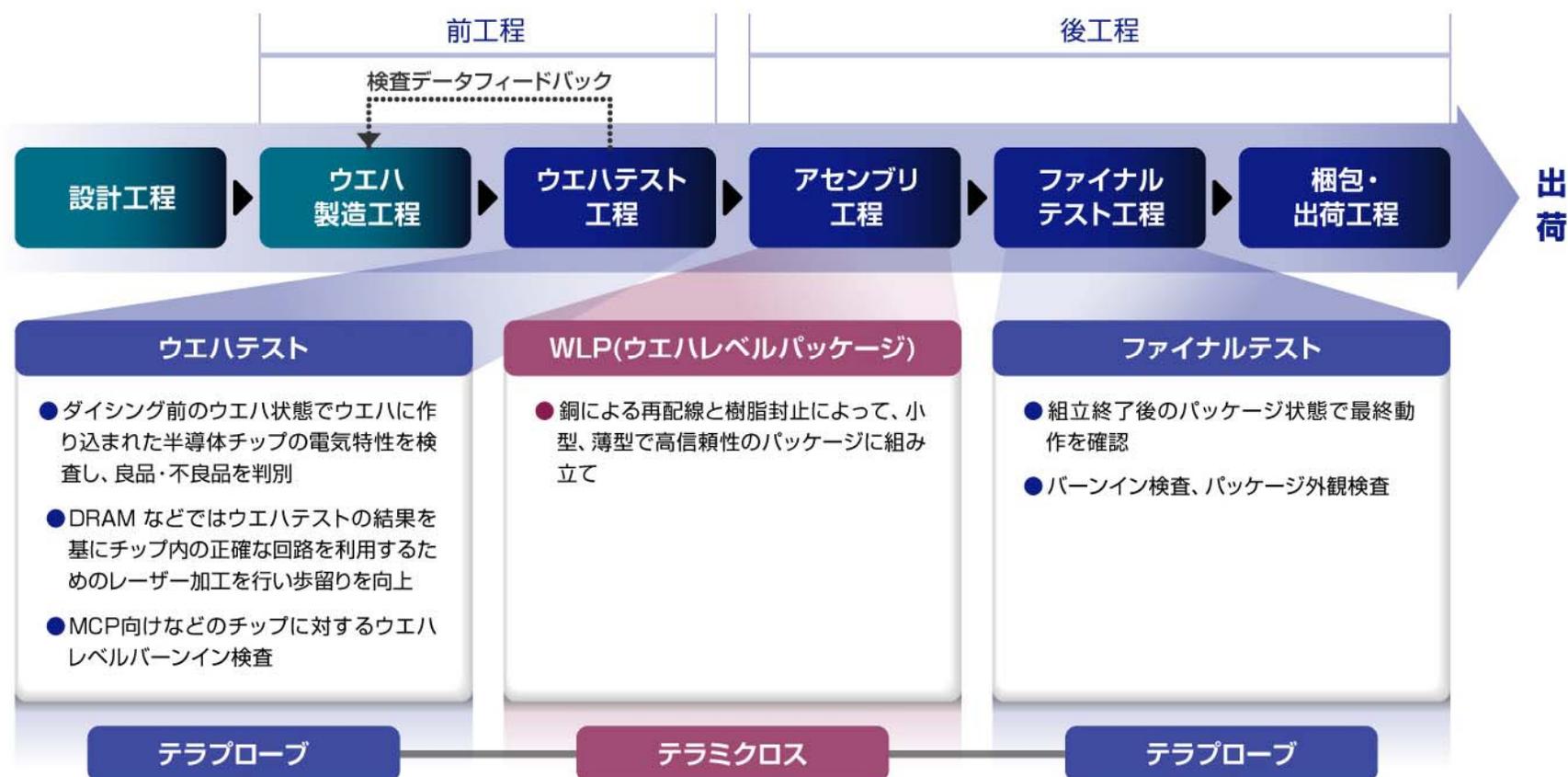
●SoC、イメージセンサ、アナログ等のテスト拠点

広島事業所 (広島県東広島市)

●メモリ系のテスト拠点

半導体製造工程における当社事業の役割

- テストオペレーションの他、治工具の設計、テストプログラムの開発、製品レイアウトへのアドバイスまで
- 半導体製造のバックエンド（後工程）ターンキーサービスにより、顧客の利便性を向上



バックエンドターンキーサービスとは、顧客がウェハ検査後の全ての工程を一括で委託することで、品質、納期等の管理を一元化できるサービスです。

本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ(以下、弊社)の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が作成する「平成25年3月期第1四半期決算短信」をご覧ください。また、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ
コーポレートプランニング・IR部門

TEL (045)476-5711

URL <http://www.teraprobe.com>